

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零二二年第一季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2022年5月12日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二二年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零二二年第一季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入再創歷史新高，達 5.946 億美元，同比上升 95.1%，環比上升 12.6%。
- 毛利率 26.9%，同比上升 3.2 個百分點，環比下降 5.6 個百分點。
- 期內溢利 1.021 億美元，同比上升 387.9%，環比下降 25.6%。
- 母公司擁有人應佔溢利 1.029 億美元，同比上升 211.4%，環比下降 22.9%。
- 基本每股盈利 0.079 美元，同比上升 216.0%，環比下降 23.3%。
- 淨資產收益率（年化）14.1%，同比上升 8.9 個百分點，環比下降 5.1 個百分點。

二零二二年第二季度指引

- 我們預計銷售收入約 6.15 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 28%至 29%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對第一季度業績評論到：

“面對複雜的疫情壓力和多變的市場形勢，華虹半導體立足‘特色 IC + Power Discrete’戰略定位，在二零二二第一季度交出了一份鼓舞人心的成績單。非易失性存儲器、功率器件、模擬和電源管理、邏輯和射頻、圖像傳感器等特色工藝平臺穩定發力、持續引領增速，公司單季收入達到創紀錄的 5.946 億美元，同比上升 95.1%，環比上升 12.6%，12 英寸的銷售占比達 44.1%，去年同期為 17.9%，上季度為 38.9%。在今年汽車和新能源等領域的‘缺芯’持續延續的背景下，市場對特色工藝的需求維持在高位，助推產品的平均銷售價格全面提振。持續增長的數據繪出一條亮麗的‘上行線’，跑出華虹加速度。”

唐先生繼續說道，“當前，新冠疫情防控任務吃緊，世界經濟復蘇前路坎坷。但困難常常伴隨希望，挑戰往往蘊含機遇。公司制訂了疫情防控有效措施，全體員工認真細緻嚴謹執行。截止目前，公司疫情防控有效、生產組織有序、產線產能飽滿、員工幹勁充沛。我們始終相信，應對困難的最好利器是發展，迎接挑戰的最佳選擇是創新。華虹半導體作為集成電路產業鏈的重要一環，背後是廣闊的汽車電子、工業控制、綠色能源、物聯網、新一代通信等終端市場，我們將以市場和技術創新為導向，加大華虹特色工藝研發投入力度，為市場提供‘特色 IC + Power Discrete’工藝平臺，為客戶提供更高性能、更低功耗、更安全可靠的分類化產品解決方案。為構築發展戰略新優勢，進一步提升華虹半導體在全球晶圓代工領域的影響力，繼續做大業務規模，做強‘特色 IC + Power Discrete’工藝平臺，我們將全速推進華虹無錫 12 英寸生產線的產能擴充，以滿足不斷增長的市場需求。

在此感謝所有股東、客戶、供應商的大力支持，公司全體員工將繼續認真執行‘四個保護好’的疫情防控要求，堅守本職崗位、奉獻公司發展，在華虹特色工藝高質量發展中不懈努力，華虹半導體必將創下新紀錄、書寫新篇章！”

電話會議公告

日期 2022 年 5 月 12 日（星期四）

時間： 16:00 香港/上海時間
04:00 美國東部時間

發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/7m7kiwn6>

(注：需要註冊才能訪問網絡直播)

電話直撥： 請在會議前使用以下連結先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼、密碼和唯一的註冊人 ID。

<http://apac.directeventreg.com/registration/event/8548907>

重要提示：在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的密碼和註冊人 ID 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共用您的註冊人 ID。

電話會議登入名： 8548907

網上重播：

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等「8 英寸 + 12 英寸」特色工藝技術的持續創新，「特色 IC + Power Discrete」強大的工藝技術平台有力支持物聯網等新興領域應用，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有「8 英寸 + 12 英寸」生產線先進工藝技術的企業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片。同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能 6.5 萬片的 12 英寸晶圓廠（華虹七廠），不僅是中國大陸領先的 12 英寸特色工藝生產線，亦為全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	594,648	304,843	528,317	95.1 %	12.6 %
銷售成本	(434,625)	(232,685)	(356,800)	86.8 %	21.8 %
毛利	160,023	72,158	171,517	121.8 %	(6.7)%
毛利率	26.9 %	23.7 %	32.5 %	3.2	(5.6)
經營開支	(75,264)	(59,502)	(31,866)	26.5 %	136.2 %
其他收入淨額	10,479	7,121	27,812	47.2 %	(62.3)%
稅前溢利	95,238	19,777	167,463	381.6 %	(43.1)%
所得稅抵免/(開支)	6,865	1,148	(30,213)	498.0 %	(122.7)%
期內溢利	102,103	20,925	137,250	387.9 %	(25.6)%
淨利潤率	17.2 %	6.9%	26.0%	10.3	(8.8)
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	102,944	33,059	133,528	211.4 %	(22.9)%
非控股權益	(841)	(12,134)	3,722	(93.1)%	(122.6)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.079	0.025	0.103	216.0 %	(23.3)%
攤薄	0.078	0.025	0.101	212.0 %	(22.8)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,057	669	1,022	58.0 %	3.4 %
產能利用率 ¹	106.0 %	104.2 %	105.4 %	1.8	0.6
淨資產收益率 ²	14.1 %	5.2 %	19.2 %	8.9	(5.1)

二零二二年第一季度

- 銷售收入再創歷史新高，達 5.946 億美元，同比上升 95.1%，環比上升 12.6%。
- 銷售成本 4.346 億美元，同比上升 86.8%，主要由於晶圓銷售量上升，環比上升 21.8%，主要由於獎金及折舊成本上升。
- 毛利率 26.9%，同比上升 3.2 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲，部分被折舊成本上升所抵消，環比下降 5.6 個百分點，主要由於一項政府補助的審計調整，獎金和折舊成本上升，部分被平均銷售價格上漲所抵消。
- 經營開支 7,530 萬美元，同比上升 26.5%，主要由於獎金增加，環比上升 136.2%，主要由於一項政府補助的審計調整以及獎金增加。
- 其他收入淨額 1,050 萬美元，同比上升 47.2%，主要由於本季度為外幣匯兌收益，上年同期為外幣匯兌損失，部分被財務費用增加所抵消，環比下降 62.3%，主要由於外幣匯兌收益下降。
- 所得稅抵免 690 萬美元，同比上升 498.0%，主要由於以前年度計提的代扣代繳股息稅的轉回增加，部分被所得稅開支所抵消。
- 期內溢利 1.021 億美元，同比上升 387.9%，環比下降 25.6%。
- 母公司擁有人應佔溢利 1.029 億美元，同比上升 211.4%，環比下降 22.9%。
- 基本每股盈利 0.079 美元，同比上升 216.0%，環比下降 23.3%。
- 淨資產收益率（年化）14.1%，同比上升 8.9 個百分點，環比下降 5.1 個百分點。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

分部經營業績³
(以千美元計，營運數據除外)

	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
華虹 8 吋					
銷售收入	332,603	250,196	322,631	32.9 %	3.1 %
毛利	128,451	68,194	146,589	88.4 %	(12.4)%
毛利率	38.6 %	27.3 %	45.4 %	11.3	(6.8)
經營開支	(40,587)	(32,528)	3,101	24.8 %	(1,408.8)%
稅前溢利	94,629	44,540	157,562	112.5 %	(39.9)%
息稅折舊及攤銷前利潤	130,824	82,883	174,328	57.8 %	(25.0)%
息稅折舊及攤銷前利潤率	39.3 %	33.1 %	54.0 %	6.2	(14.7)
付運晶圓(8 吋仔片)	571	541	617	5.5 %	(7.5)%
華虹無錫					
銷售收入	262,045	54,647	205,686	379.5 %	27.4 %
毛利	31,572	3,964	24,928	696.5 %	26.7 %
毛利率	12.0 %	7.3 %	12.1 %	4.7	(0.1)
經營開支	(34,677)	(26,974)	(34,967)	28.6 %	(0.8)%
稅前溢利	609	(24,763)	9,901	(102.5)%	(93.8)%
息稅折舊及攤銷前利潤	88,427	9,688	78,230	812.7 %	13.0 %
息稅折舊及攤銷前利潤率	33.7 %	17.7 %	38.0 %	16.0	(4.3)
付運晶圓(折合 8 吋仔片)	486	128	405	279.7 %	20.0 %

華虹 8 吋

- 銷售收入 3.326 億美元，同比上升 32.9%，環比上升 3.1%。
- 毛利率 38.6%，同比上升 11.3 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲及產品組合優化，環比下降 6.8 個百分點，主要由於一項政府補助的審計調整以及獎金增加，部分被平均價格上漲所抵消。
- 經營開支 4,060 萬美元，同比上升 24.8%，主要由於獎金增加，環比上升 1,408.8%，主要由於一項政府補助的審計調整。
- 稅前溢利 9,460 萬美元，同比上升 112.5%，環比下降 39.9%。

華虹無錫

- 銷售收入 2.620 億美元，同比上升 379.5%，環比上升 27.4%。
- 毛利率 12.0%，同比上升 4.7 個百分點，環比下降 0.1 個百分點。
- 經營開支 3,470 萬美元，同比上升 28.6%，主要由於獎金及研發工程片開支上升。
- 息稅折舊及攤銷前利潤 8,840 萬美元，環比上升 13.0%。

³以上各分部的經營業績均為抵消分部間銷售后的數據。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二二年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第一季度 % (未經審核)	二零二一年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	574,651	96.6 %	291,834	95.7 %	282,817	96.9 %
其他	19,997	3.4 %	13,009	4.3 %	6,988	53.7 %
銷售收入總額	594,648	100.0 %	304,843	100.0 %	289,805	95.1 %

- 本季度 96.6%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二二年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第一季度 % (未經審核)	二零二一年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	332,603	55.9 %	250,196	82.1 %	82,407	32.9 %
12 吋晶圓	262,045	44.1 %	54,647	17.9 %	207,398	379.5 %
銷售收入總額	594,648	100.0 %	304,843	100.0 %	289,805	95.1 %

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 3.326 億美元及 2.620 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二二年	二零二二年	二零二一年	二零二一年	同比	同比
	第一季度 仟美元 (未經審核)	第一季度 % (未經審核)	第一季度 仟美元 (未經審核)	第一季度 % (未經審核)	仟美元	%
中國 ⁴	451,638	76.0 %	219,735	72.0 %	231,903	105.5 %
美國 ⁵	58,064	9.8 %	28,309	9.3 %	29,755	105.1 %
亞洲 ⁶	54,885	9.2 %	35,894	11.8 %	18,991	52.9 %
歐洲	22,081	3.7 %	14,801	4.9 %	7,280	49.2 %
日本 ⁷	7,980	1.3 %	6,104	2.0 %	1,876	30.7 %
銷售收入總額	594,648	100.0 %	304,843	100.0 %	289,805	95.1 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 4.516 億美元，占銷售收入總額的 76.0%，同比增長 105.5%，主要得益於各個技術平台產品的需求增加。
- 本季度來自於美國的銷售收入 5,810 萬美元，同比增長 105.1%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 5,490 萬美元，同比增長 52.9%，主要得益於邏輯、通用 MOSFET 及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 2,210 萬美元，同比增長 49.2%，主要得益於智能卡芯片、通用 MOSFET 及 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度來自於日本的銷售收入 800 萬美元，同比增長 30.7%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。

⁴包括香港。

⁵包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁶不包括中國及日本。

⁷包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二二年	二零二二年	二零二一年	二零二一年	同比	同比
	第一季度 仟美元 (未經審核)	第一季度 % (未經審核)	第一季度 仟美元 (未經審核)	第一季度 % (未經審核)	仟美元	%
嵌入式非易失性存儲器	142,258	23.9 %	94,506	31.0 %	47,752	50.5 %
獨立式非易失性存儲	58,546	9.8 %	11,569	3.8 %	46,977	406.1 %
分立器件	181,342	30.6 %	109,547	35.9 %	71,795	65.5 %
邏輯及射頻	95,327	16.0 %	49,844	16.4 %	45,483	91.3 %
模擬與電源管理	116,557	19.6 %	38,771	12.7 %	77,786	200.6 %
其他	618	0.1 %	606	0.2 %	12	2.0 %
銷售收入總額	594,648	100.0 %	304,843	100.0 %	289,805	95.1 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.423 億美元，同比增長 50.5%，主要得益於 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 5,850 萬美元，同比增長 406.1%，主要得益於 NOR flash 產品的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 1.813 億美元，同比增長 65.5%，主要得益於超級結、IGBT 及通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 9,530 萬美元，同比增長 91.3%，主要得益於 CIS 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.166 億美元，同比增長 200.6%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二二年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第一季度 % (未經審核)	二零二一年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	103,031	17.3 %	12,685	4.2 %	90,346	712.2 %
90nm 及 95nm	124,360	21.0 %	44,987	14.8 %	79,373	176.4 %
0.11 μ m 及 0.13 μ m	82,825	13.9 %	63,945	21.0 %	18,880	29.5 %
0.15 μ m 及 0.18 μ m	48,626	8.2 %	36,334	11.9 %	12,292	33.8 %
0.25 μ m	3,802	0.6 %	4,594	1.5 %	(792)	(17.2)%
0.35 μ m 及以上	232,004	39.0 %	142,298	46.6 %	89,706	63.0 %
銷售收入總額	594,648	100.0 %	304,843	100.0 %	289,805	95.1 %

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 1.030 億美元，同比增長 712.2%，主要得益於 NOR flash、CIS 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 1.244 億美元，同比增長 176.4%，主要得益於其他電源管理、MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 8,280 萬美元，同比增長 29.5%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 4,860 萬美元，同比增長 33.8%，主要得益於邏輯及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 380 萬美元，同比下降 17.2%，主要由於 RF 產品的需求減少。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.320 億美元，同比增長 63.0%，主要得益於超級結、IGBT、通用 MOSFET 及其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二二年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第一季度 % (未經審核)	二零二一年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	395,076	66.3 %	189,038	62.0 %	206,038	109.0 %
工業及汽車	106,154	17.9 %	59,998	19.7 %	46,156	76.9 %
通訊	72,847	12.3 %	44,244	14.5 %	28,603	64.6 %
計算機	20,571	3.5 %	11,563	3.8 %	9,008	77.9 %
銷售收入總額	594,648	100.0 %	304,843	100.0 %	289,805	95.1 %

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 3.951 億美元，占銷售收入總額的 66.3%，同比增長 109.0%，主要得益於各個技術平台產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.062 億美元，同比增長 76.9%，主要得益於 IGBT、MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 7,280 萬美元，同比增長 64.6%，主要得益於 CIS、邏輯和智能卡芯片的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 2,060 萬美元，同比增長 77.9%，主要得益於通用 MOSFET 及 MCU 產品的需求增加。

產能⁸及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)
1 號晶圓廠 (200mm)	65	65	65
2 號晶圓廠 (200mm)	60	60	60
3 號晶圓廠 (200mm)	53	53	53
7 號晶圓廠 (300mm)	65	28	60
合計折合 8 吋產能	324	241	313
產能利用率 (200mm)	107.7%	104.3%	107.5%
產能利用率 (300mm)	103.9%	103.8%	102.5%
總體產能利用率	106.0%	104.2%	105.4%

- 本季度末月產能達 324,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 106.0%。

⁸ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋矽片晶圓	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,057	669	1,022	58.0 %	3.4 %

- 本季度付運晶圓 1,057,000 片，同比增加 58.0%，環比增加 3.4%。

經營開支分析

以千美元計	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	4,496	2,620	3,158	71.6 %	42.4 %
管理費用 ⁹	70,768	56,882	28,708	24.4 %	146.5 %
經營開支	75,264	59,502	31,866	26.5 %	136.2%

- 經營開支 7,530 萬美元，同比上升 26.5%，主要由於獎金增加，環比上升 136.2%，主要由於一項政府補助的審計調整以及獎金增加。

其他收入淨額

以千美元計	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,781	3,680	3,614	2.7 %	4.6 %
利息收入	4,322	3,037	3,441	42.3 %	25.6 %
匯兌收益/(損失)	7,140	(269)	21,619	(2,754.3)%	(67.0)%
分佔聯營公司溢利	1,855	1,512	2,436	22.7 %	(23.9)%
財務費用	(6,786)	(1,636)	(4,997)	314.8 %	35.8 %
政府補貼	1,842	544	826	238.6 %	123.0 %
其他	(1,675)	253	873	(762.1)%	(291.9)%
其他收入淨額	10,479	7,121	27,812	47.2 %	(62.3)%

- 其他收入淨額 1,050 萬美元，同比上升 47.2%，主要由於本季度為外幣匯兌收益，上年同期為外幣匯兌損失，部分被財務費用增加所抵消，環比下降 62.3%，主要由於外幣匯兌收益下降。

⁹管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	195,589	60,831	206,804	221.5 %	(5.4)%
投資活動所用現金流量淨額	(116,986)	(167,528)	(297,044)	(30.2)%	(60.6)%
融資活動所得現金流量淨額	2,439	146,928	242,187	(98.3)%	(99.0)%
外匯匯率變動影響淨額	3,752	(1,511)	13,846	(348.3)%	(72.9)%
現金及現金等價物變動影響淨額	84,794	38,720	165,793	119.0 %	(48.9)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.956 億美元，同比上升 221.5%，主要得益於銷售收入增長，部分被人工費用和材料的支出增加所抵消。
- 投資活動所用現金流量淨額 1.170 億美元，其中固定資產及無形資產投資支出 1.241 億美元，部分被收到政府對設備的補助 440 萬美元及利息收入 270 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 240 萬美元，其中提取銀行借款 4,740 萬美元和發行股份收到 120 萬美元，部分被償還銀行貸款本金 4,320 萬美元，租賃負債支出 250 萬美元及支付銀行借款利息 50 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二一年 (未經審核)
資產總額	6,316,078	6,202,099
負債總額	2,531,648	2,517,552
所有者權益總額	3,784,430	3,684,547
資產負債率 ¹⁰	40.1%	40.6%

資本開支

以千美元計	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)
華虹 8 吋	16,553	29,779
華虹無錫	107,527	352,457
合計	124,080	382,236

- 本季度資本開支 1.241 億美元，其中 1.075 億美元用於華虹無錫。

¹⁰資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二一年 (未經審核)
發展中物業	125,110	114,492
存貨	451,671	432,917
貿易應收款項及應收票據	243,443	181,042
預付款項、其他應收款項及其他資產	50,060	43,443
應收關聯方款項	7,074	6,910
已凍結存款及定期存款	2,258	2,248
現金及現金等價物	1,694,934	1,610,140
流動資產總額	2,574,550	2,391,192
貿易應付款項	243,211	194,385
其他應付款項及暫估費用	513,204	560,435
計息銀行借款	194,304	195,024
租賃負債	2,524	1,676
政府補助	67,127	66,837
應付關聯方款項	19,949	7,501
應付所得稅	67,538	54,543
流動負債總額	1,107,857	1,080,401
淨營運資金	1,466,693	1,310,791
速動比率	1.9x	1.8x
流動比率	2.3x	2.2x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	32	29
存貨周轉天數	92	105

- 貿易應收款項及應收票據 由上季度末的 1.810 億美元上升至本季度末的 2.434 億美元，主要由於銷售收入上升。
- 預付款項、其他應收款項及其他資產 由上季度末的 4,340 萬美元上升至本季度末的 5,010 萬美元，主要由於供應商預付款項增加。
- 貿易應付款項 由上季度末的 1.944 億美元上升至本季度末的 2.432 億美元，主要由於供應商應付款增加。
- 其他應付款項及暫估費用 由上季度末的 5.604 億美元下降至本季度末的 5.132 億美元，主要由於應付資本性開支減少。
- 應付關聯方款項 由上季度末的 750 萬美元上升至本季度末的 1,990 萬美元，主要由於收到關聯方的預付租金款
- 應付所得稅 由上季度末的 5,450 萬美元上升至本季度末的 6,750 萬美元，主要由於計提本季度所得稅開支。
- 淨營運資金 本季度末 14.667 億美元，流動比率 2.3。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 32 天。
- 存貨周轉天數 92 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二一年 (未經審核)
銷售收入	594,648	304,843	528,317
銷售成本	(434,625)	(232,685)	(356,800)
毛利	160,023	72,158	171,517
其他收入及收益	17,721	7,604	30,190
投資物業的公平值收益	(316)	-	183
銷售及分銷費用	(4,496)	(2,620)	(3,158)
管理費用	(70,768)	(56,882)	(28,708)
其他費用	(1,995)	(359)	-
財務費用	(6,786)	(1,636)	(4,997)
分佔聯營公司溢利	1,855	1,512	2,436
稅前溢利	95,238	19,777	167,463
所得稅抵免/(開支)	6,865	1,148	(30,213)
期內溢利	102,103	20,925	137,250
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	102,944	33,059	133,528
非控股權益	(841)	(12,134)	3,722
持有人應佔每股盈利			
基本	0.079	0.025	0.103
攤薄	0.078	0.025	0.101
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,301,453,841	1,299,428,463	1,300,675,399
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,319,204,155	1,325,196,463	1,320,444,781

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二一年 (已審核)	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	3,053,141	3,116,501	2,498,485
投資物業	185,369	184,883	179,202
使用權資產	76,681	75,331	77,050
無形資產	33,487	35,312	36,841
於聯營公司的投資	124,420	122,040	107,436
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	236,005	257,788	228,639
長期預付款項	23,710	15,573	29,447
應收關聯方款項	-	-	17
遞延稅項資產	8,715	3,479	9,538
非流動資產總額	3,741,528	3,810,907	3,166,655
流動資產			
發展中物業	125,110	114,492	106,040
存貨	451,671	432,917	283,764
貿易應收款項及應收票據	243,443	181,042	127,613
預付款項、其他應收款項及其他資產	50,060	43,443	29,280
應收關聯方款項	7,074	6,910	7,220
已凍結存款及定期存款	2,258	2,248	356
現金及現金等價物	1,694,934	1,610,140	961,506
流動資產總額	2,574,550	2,391,192	1,515,779
流動負債			
貿易應付款項	243,211	194,385	124,799
其他應付款項及暫估費用	513,204	560,435	346,232
計息銀行借款	194,304	195,024	90,959
租賃負債	2,524	1,676	1,884
政府補助	67,127	66,837	67,609
應付關聯方款項	19,949	7,501	23,469
應付所得稅	67,538	54,543	31,432
流動負債總額	1,107,857	1,080,401	686,384
流動資產淨額	1,466,693	1,310,791	829,395
總資產減流動負債	5,208,221	5,121,698	3,996,050
非流動負債			
計息銀行借款	1,400,496	1,395,279	618,261
租賃負債	15,429	16,137	16,689
遞延稅項負債	7,866	25,735	5,583
非流動負債總額	1,423,791	1,437,151	640,533
淨資產	3,784,430	3,684,547	3,355,517
權益和負債權益			
股本	1,987,216	1,986,152	1,984,004
儲備	980,308	884,207	563,599
本公司擁有人應佔權益	2,967,524	2,870,359	2,547,603
非控股權益	816,906	814,188	807,914
權益總額	3,784,430	3,684,547	3,355,517

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二一年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	95,238	19,777	167,463
折舊及攤銷	117,227	71,158	80,117
應佔聯營公司溢利	(1,855)	(1,512)	(2,436)
營運資金的變動及其它	(15,021)	(28,592)	(38,340)
經營活動所得現金流量淨額	195,589	60,831	206,804
投資活動所用現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(124,080)	(167,357)	(382,236)
收到政府對物業、廠房及設備的補助	4,356	-	83,594
投資聯營公司	-	(1,484)	-
其他投資活動所得現金流量	2,738	1,313	1,598
投資活動所用現金流量淨額	(116,986)	(167,528)	(297,044)
融資活動所得現金流量：			
提取銀行貸款	47,413	143,208	275,021
發行股份所得收益	1,252	6,498	410
償還銀行貸款	(43,208)	-	(26,099)
償還租賃負債	(2,484)	(2,709)	(632)
已付利息	(534)	(69)	(6,513)
融資活動所得現金流量淨額	2,439	146,928	242,187
現金及現金等價物增加淨額	81,042	40,231	151,947
外匯匯率變動影響淨額	3,752	(1,511)	13,846
期初現金及現金等價物	1,610,140	922,786	1,444,347
期末現金及現金等價物	1,694,934	961,506	1,610,140

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壘太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二二年五月十二日